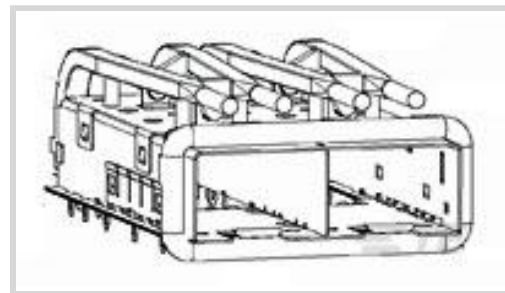




连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP、SFP+ 和 zSFP+ > zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片



插拔式 I/O 产品类型: 壳体组件

可密封: 否

电路应用: Signal

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

数据速率 (最大值) : 28 Gb/s

[所有 zSFP+ 壳体组件：EMI 弹片 \(24\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

笼子类型	联动
插拔式 I/O 产品类型	壳体组件
可密封	否
外形尺寸	zSFP+

### 结构特性

光管种类	标准
端口数量	2
端口矩阵配置	1 x 2

### 电气特征

数据速率 (最大值)	28 Gb/s
------------	---------

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.05 mm [.081 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

### 壳体特性

笼子材料	镍/银合金
------	-------

### 尺寸

PCB 厚度 (建议)	2.25 mm
-------------	---------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

插拔式 I/O 应用	EMI 增强型
------------	---------

兼容的散热器	否
--------	---

电路应用	Signal
------	--------

### 包装特性

封装方法	Tray
------	------

### 其他

包括的光管	是
-------	---

EMI 遏制特性类型	内部/外部 EMI 簧片
------------	--------------

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



## 客户还购买了





TE 产品编号1551920-2  
zQSFP+ connector assembly



TE 产品编号2302796-1  
RAPLUGASSY,LEFTEND,HALF,RTM,  
VPX,MGRT3

## 文档

### 产品图纸

[zSFP+ 1x2 Cage Assy, Press-Fit, LP](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227727-1\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227727-1\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2227727-1\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[zSFP+ Interconnect Brochure](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本